EXPERIMENTAL DEMONSTRATION OF MOVABLE MASK WITH LOW BEAM IMPEDANCE

Yusuke Suetsugu^{1,A)}, Kyo Shibata^{A)}, Akira Morishige^{B)}, Yasuaki Suzuki^{B)}, Masao Tsuchiya^{B)} ^{A)} High Energy Accelerator Research Organization (KEK), 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan ^{B)} Kinzokugiken Co, Ltd., 713 Shake Aza Narihira, Ebina, Kanagawa 243-0424, Japan

Abstract

A new-type movable mask (collimator) with low beam impedance for future high-intensity accelerators has been proposed and investigated in KEK. A conductive mask head is supported by a dielectric material in order to reduce the interference with beams. The present test model had a head and support made of graphite and artificial diamond, respectively. The test model was installed into the KEK B-factory (KEKB) positron ring, and tested with real beams up to a beam current of 1300 mA to prove the principle. The temperatures of bellows and SiC HOM absorbers near to the new-type masks were found to be lower than those in the case of old-type ones. This fact indicated that the HOM excitation was mitigated by using the new-type mask.

低インピーダンス型可動マスクの実証実験

1. はじめに

可動マスク(コリメータ)とは、加速器において正 規のビーム軌道から外れた荷電粒子の通過を制限し、 測定器のノイズを低減、またはビームの質を向上さ せるための真空機器である^[1-3]。可動マスクは、そ のヘッド(荷電粒子を遮断する物質)がビームの極近 傍にあるため、必然的にビームインピーダンスが高 くなる。その結果、発生した高次高周波(Higher Order Modes, HOM)によってビーム振動が励起され たり、近傍の機器が加熱されたりしやすい。また、 予期せぬビーム本体の衝突によるヘッドの損傷も問 題となる。これらの課題に対応した可動マスクの開 発は、将来の大強度加速器を実現する上で重要な R&D項目の一つとなっている^[4]。

我々は、従来よりも低いインピーダンスを持つ新 しい構造の可動マスクを提案した^[5]。誘電体で導電 性のマスクヘッドを支える構造とすることにより、 ビームとの干渉が減り、インピーダンスが小さくで きる。これまで、シミュレーションを通して本構造 の高周波特性や熱特性を評価し、その実現可能性を 検討してきた。また、2007年には試作1号機をKEK Bファクトリー (KEKB)の陽電子リングに設置し、 実機ビームを使った試験を行った^[6]。

今回、これまでの検討・試験結果を踏まえ、試作 2号機を同リングに設置して、ビーム運転中のヘッ ドの温度、近傍のベローズチェンバーやSiC HOM吸 収体冷却水の温度等を測定した。そして、それらの 温度上昇が旧型マスクの場合に比ベ少なくとも1/2 程度まで減少することを確認し、この新型マスクに よってHOMの発生が低減されることを実験的に実 証することができた。ここでは、試作2号機のビー ム試験の結果、問題点、および今後の方針等につい て報告する。

2. 試作2号機

試作1号機は、マスクヘッドとサポートをアルミ ナ(99% Al₂O₃)で製作し、ヘッド部分のみに銅(厚み 約10 μ m)をコーティングした^[6]。形状的には提案し た構造と同じであったが、サポートがアルミナで あったためサポートを通しての伝熱はほとんど期待 できず、ヘッドへの入熱は主に輻射によりチェン バー側に伝達されることになった。アルミナ自体の 高周波での誘電損も大きかった。その結果、ビーム 試験では、ビーム電流700 mA (1389バンチ、 I_6^2/N_b = 350 mA²)の時、圧力のバーストと同時にヘッド温度 が1300 ℃以上に達した。マスクヘッドの銅のコー ティングはほとんど消失し、ヘッドとサポートの接 続部分のアルミナが溶融していた^[6]。残念ながら原 理実証には至らなかった。

今回の試作2号機は、1号機の経験を元に、形状は ほぼ同じであるが構成材料が見直された。試作した マスクヘッド部を図1に示す。ヘッドにはグラファ イト(コンポジット材)を採用した。グラファイトは 融点が約3000 ℃と熱的強度が高い導体であり(導電



図1:可動マスク試作2号機マスクヘッド部分

¹ E-mail: yusuke.suetsugu@kek.jp

率1×10⁵ Ω^{-1} m⁻¹)、輻射率も高い($\varepsilon > 0.7$)。一方サポートには人工ダイアモンドを用いた。ダイアモンドは 誘電体($\varepsilon_r = 6$)であるが、熱伝導率が室温にて1 Wmm⁻¹K⁻¹と銅よりも高い。つまり、ヘッドへの入 熱は輻射ばかりではなくサポートを通した熱伝導で もチェンバー側に伝わり、試作1号機に比べて熱的 強度を高めることができる。熱解析では、KEKBの 典型的なフィルパターンである1389バンチ1700 mA ($I_b^2/N_b = 2000 \text{ mA}^2$)でも、ヘッドでの最高温度は 780 ℃と材質的には問題無い範囲であった(解析で は熱伝導率を室温の約半分とした)。なお、ロス ファクターは約2.1×10¹⁰ VC⁻¹であった(バンチ長6 mm)。ちなみに、同条件での既存の可動マスクのロ スファクターは約5×10¹¹ VC⁻¹である。

ヘッドは長さ90 mm、幅5 mm、厚み5 mmの直方 体である。サポートは高さ38 mm、幅5 mm、厚みは 1.2 mmである。ただし、今回サポートには導電性膜 は付けなかった。また、現象を単純にするためにテ ストチェンバーにはHOM吸収体(SiC)は取り付けな かった。グラファイトとダイアモンドはロウ付けで 接合した。さらに、ダイアモンドサポートの根元に 銅ブロック(台座)をロウ付けし、この銅の台座を チェンバーに固定した。マスクヘッドとビームとの 距離は正規の位置で10 mmであった。

3. ビームテスト

3.1設置

試作2号機2台(V₁、V₂)は、2008年冬にKEKB陽電 子リングの既存の垂直方向可動マスクと入れ替えら れた。ヘッド中央部の温度はチェンバーのサファイ ア窓を通して赤外温度計(波長1.6 μm)で測定した。 近傍のベローズチェンバーのベローズひだ、および 可動マスクチェンバー本体の温度も常時監視した。 ベローズひだの温度は発生するHOMの強度の指針 となる。なぜなら、その温度上昇はベローズのフィ ンガー型RFシールドから漏れ出るTEモードのHOM が主な原因だからである。また、可動マスクの近傍 に設置されているHOM吸収体付きチェンバーの冷 却水温度も測定した。試作機(V₁、V₂)、旧型水平マ スク(H₁、H₂)、ベローズチェンバー(B)、HOM吸収 体(A₁, A₂)等のリングでの位置関係を図2に示す。



図3:旧型(Before)と試作機(After)設置時の可動 マスク(V₁, V₂)近傍のベローズひだの温度。

3.2 ベローズひだの温度

図3に、設置した2台の垂直方向マスク(V_1 、 V_2) 近くにある4個のベローズひだの温度(平均値)の ビーム電流に対する変化を示す。バンチ数は1585、 バンチ間隔約6 ns、バンチ長約7 mmである。旧型マ スクを設置していた時のベローズひだ温度(Before) と比べると。ビーム電流1300 mA (I_b^2/N_b = 1100 mA²) までの範囲で、温度上昇率は約1/2になっている。 これは、試作機に交換することで発生するHOMの パワーが減少したことを示している。また、 V_1 、 V_2 マスクの上流、下流にある旧型水平方向マスク(H_1 、 H_2)の近傍のベローズひだ温度上昇率も約30%低下 した。これはHOMがビームパイプ内を伝搬してい るためである。このことは、逆に図3の温度上昇に も H_1 、 H_2 の影響が含まれていることを示唆する。

3.3 HOM吸収体チェンバーのSiC冷却水の温度

 V_2 マスクから約10 m上流側にあるHOM吸収体 チェンバー(A₁)のSiC冷却水出口温度の変化を図4 に示す。チェンバーには2本のSiC (SiC_1、SIC_2)が 挿入されていて、SiC_1とSiC_2の冷却水は連続して 接続されている^[7]。旧型マスク設置時と比較してみ ると、温度上昇が約40%低下しているのがわかる。 これはHOM発生量が減少したことを直接示すもの である。冷却水の流量は4 l s⁻¹であることから、例



図2:試作機(V_1 、 V_2)近くのコンポーネント配置図。Q:四極電磁石、B:ベローズチェンバー、 H_1 、 H_2 :旧型水平方向可動マスク、 A_1 、 A_2 :HOM吸収体チェンバー。



図4:旧型(Before)と試作機(After)の場合の HOM吸収体チェンバー(A₁)のSiC冷却水の温 度。SiC_1とSiC_2は連続して冷却されている。

えばビーム電流1300 mAでの4 ℃の低下は、吸収パ ワーが1.1 kW減少したことになる。ここで、HOM 吸収体チェンバーのSiCが垂直方向に設置されてい ることに注意すべきである。この配置では、水平方 向に偏極しているHOMに対して吸収効率が大きい。 つまり、水平方向マスクのHOMを効率良く吸収す る。このことから、試作2号機を使用することで実 際に減少したHOMパワーは、図4の冷却水の温度 変化から単純に計算される値より大きいと推定され る。もう一つのHOM吸収体チェンバー(A₂)でもSiC 冷却水温度の低下が確認された。

3.4 破損

ビーム電流900 mA $(I_b^2/N_b = 510 \text{ mA}^2)$ 程度から、試 作機内部の温度が予想以上に上昇していることが観 測された。そして、1300 mA $(I_b^2/N_b = 510 \text{ mA}^2)$ にて 付近の圧力の突出と同時にビームロスが発生した。 内部を確認したところ、 V_1 マスクのサポート部が破 損していることがわかった(図 5)。

サポートは銅の台座に近いところで破断していた。 台座のロウ付けは残っていたが、サポートのエッジ 部分で放電跡が確認された。ダイアモンドは炭化し、



図5:破損したV1マスクのヘッド、サポート。

導電性が認められた。これはサポートの温度が 1500 ℃以上になったことを示す。

破損の原因は、破損の状況や運転中の温度の振る 舞いから、サポート部で放電が発生したためと推定 された。放電の原因としては、次のようなことが考 えられる。(1)ダイアモンドの欠陥。同一条件で試 験していたV₂マスクのサポートは健全だった。(2) 銅-ダイアモンドのロウ付け部の不具合。(3)いわゆ る三重点(ダイアモンド、銅(金属)と真空)からの電 子放出に起因する沿面放電。ダイアモンドの高い二 次電子放出率が誘引の一つとも考えられる。

4. まとめと今後の方針

試作2号機を用いて提案した可動マスクの実験を 行い、ビーム電流1300 mA (*I*_b²/*N*_b = 1100 mA²)までの 範囲で発生するHOMが低減されることを実験的に 実証した。しかし、最終的には予想より低い電流で サポート部が破損した。さらに高い電流に対応する ために、以下のような改良を考えている;(1)ロウ 付け部の電界強度を下げる構造とする、(2)より均 ーな特性とするためダイアモンドの品質を上げる、 (3) 沿面放電の成長を抑えるためサポートを傾ける、 (4)サポートの表面に薄い導電性膜を付ける、等。

リングに設置する前の地上試験も検討している。 今回の放電現象を確認するために、1.25 GHzのマイ クロ波導波管内(真空中)にマスクヘッド部分を設置 し高電力のマイクロ波を通過させてサポート部を観 察した。その結果、約70 kW入力時に放電を確認す ることができた。実際のバンチとは周波数スペクト ルが異なるが、マスクヘッド部の放電特性を評価す る良い指針になると考えている。

謝辞

本研究にあたり、KEKB RFグループの影山達也氏、 阿部哲郎氏、竹内保直氏には計算および実験に対し てご協力を頂きました。また、KEKBの生出勝宣氏、 金澤健一氏には多くの助言を頂きました。ここに深 謝します。

参考文献

- Y. Suetsugu, K. Shibata, T. Sanami, T. Kageyama and Y. Takeuchi, RSI, 74 (2003) 3297.
- [2] Y. Suetsugu, T. Kageyama, K. Shibata and T. Sanami, NIM-PR-A, 513 (2003) 465.
- [3] Y. Suetsugu, "Vacuum System for High Power Lepton Rings", PAC2003, Portland (OR), 2003 May 12-16, p.612.
- [4] Y. Suetsugu, K. Kanazawa, S. Kato, H. Hisamatsu, M. Shimamoto and M. Shirai, J. Vac. Sci. Technol., A21 4 (2003) 1436.
- [5] Y. Suetsugu, K. Shibata, A. Morishige, Y. Suzuki and M. Tsuchiya, PRST-AB, 9 (2006) 103501.
- [6] Y. Suetsugu and K. Shibata, Proceedings of PAC2007 (June 25-30, Albuquerque, 2007), p.2587.
- [7] Y.Suetsugu, T.Kageyama, Y.Takeuchi and K.Shibata, NIM-PR-A, 533 (2004) 295.